

鈦鋨錳氧薄膜之成長與傳輸特性之研究

林靖凱、王立民

E-mail: 9708114@mail.dyu.edu.tw

摘要

我們以射頻磁控濺鍍的方式(RF magnetron sputtering)成長Nd_{0.47}Sr_{0.53}MnO₃薄膜，進而研究樣品在不同基座、不同成長溫度及不同成長壓力下，其物理特性的改變。我們使用X-ray繞射分析薄膜結晶結構及晶格應力。我們發現當成長溫度愈高時，其應力會有增加的趨勢。而熱激活能E則隨成長壓力之增加而減小，且當通氣退火後使得應力和電阻率變小。另外，在鈦酸鋨SrTiO₃(001)基座成長不同比例成份之鈦鋨錳氧Nd_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃薄膜，探討不同外加磁場下之磁阻特性、金屬-絕緣體相變溫度TP與溫度電阻係數(Temperature coefficient of resistance, TCR)特性分析及熱激活能E變化與TCR之關係。在H=7 T時，有最大之負磁阻約為2669%，在H=0 T時，有最大之TCR值為10.6 %K⁻¹。熱激活能E則隨磁場之增加而減小。

關鍵詞：射頻磁控濺鍍；金屬-絕緣體相變溫度；電阻的溫度係數；磁阻；熱激活能

目錄

封面內頁 簽名頁 授權書	iii 中文摘要
iv 英文摘要	v 謹謝
vi 目錄	vii 圖目錄
x 表目錄	xiii
第一章 緒論	1.1.1 前言
. 1.1.2 龐磁阻(Colossal Magnetoresistance, CMR)材料簡介	4 1.4
具高TCR之含錳氧化物材料研究發展現況	10 1.5 CMR薄膜通氣退火之介紹
目的	13 1.6 研究目的
17 第二章 理論基礎	18 2.1 磁性之起源
18 2.2 磁阻	22 2.3 雙交換理論
25 2.4 Jahn-Teller distortion	26 2.5 CMR材料之電阻傳輸機制
27 2.5.1 極化子之傳輸機制	27 2.5.2 輽子崩潰模型
27 2.6 應力效應	30 第三章 實驗方法與儀器設備
32 3.1 實驗流程	32 3.2 樣品製作:靶材製作
33 3.2.1 固態燒結法	33 3.2.2 靶材製作流程敘述
33 3.2.3 薄膜成長	37 3.3 實驗儀器介紹
真空鍍膜系統與離子蝕刻系統	39 3.3.2 X-ray繞射分析儀
儀(EDS)	41 3.3.3 成分分析
43 3.3.4 電性量測	44 3.3.5 磁化強度之量測
45 3.3.6 高溫爐管	45 3.3.7 薄膜測厚儀
46 3.3.8 電阻率-溫度之微分與TCR之計算	48 第四章 結果與討論
49 4.1 Nd _{0.47} Sr _{0.53} MnO ₃ (NSMO47)薄膜之成長與特性分析	49 4.1.1 不同成長溫度NSMO47薄膜之結構、應力、電性分析
49 4.1.2 不同成長壓力NSMO47薄膜之結構、應力、電性分析	57 4.1.3 NSMO47薄膜成長於不同基座之特性分析
74 4.2 Nd _{0.7} Sr _{0.3} MnO ₃ (NSMO07)薄膜之長特性分析	64 4.1.4 通氣退火效應
79 4.2.2 外加磁場下之TCR特性分析	79 4.2.1 外加磁場下之磁阻特性分析
82 4.2.3 外加磁場下之熱激活能變化與TCR之關係	82 4.2.3 外加磁場下之熱激活能變化與TCR之關係
86 第五章 結論	90 參考文獻
91	

參考文獻

- [1] H. J. Lee, J. H. Jung, J. S. Lee, and T. W. Noh, Phys. Rev. B 60, 5251 (1999).
- [2] S. Valencia, L. Balcells, J. Fontcuberta, and B. Martinez, Appl. Phys. Lett. 82, 4531 (2003).
- [3] F. Rivadulla, L. E. Hueso, D. R. Miguens, J. Appl. Phys. 91, 7412 (2006).
- [4] Michael Ziese and Chatthai, Phys. Rev. B 58, 11519 (1998).

- [5]Yu Lu, X. W. Li, G. Q. Gong, Gang Xiao, A. Gupta, P. Lecoeur, J. Z. Sun, Y. Y. Wang, and V. P. Dravid, Phys. Rev. B 54, R8357 (1996). J. S. Noh, T. K. Nath, C. B. Eom, J. Z. Sun, W. Tian, and X. Q. Pan, Appl. Phys. Lett. 79, 233 (2001).
- [6]Alvydas Lissauskas, S. I. Khartsev, and Alex Grishin, Appl. Phys. Lett. 77, 756 (2000). Fan Yang, Laurence Mechin, Jean-Marc Routou, Bruno Guillet, and Radoslav A. Chakalov, J. Appl. Phys. 99, 024903 (2006).
- [7]C. Zener, Phys. Rev. 82 403 (1951).
- [8]H.Y. Hwang, S-W. Cheong, P. G. Radaelli, M. Marezio, and B. Batlogg, Phys. Rev. Lett. 75, 914 (1995).
- [9]S. Y. Wu, W. -H. Li, K. C. Lee, T. H. Meen, and H. D. Yang, 79, p6571-6573 (1996).
- [10]W. -H. Li, Y. F. Lin, S. Y. Wu, K. C. Lee, J. W. Lynn, and H. C. Ku, J. Appl. Phys. 79 , p6568-6570 (1996).
- [11]W. -H. Li, W. Y. Chuang, S. Y. Wu, and K. C. Lee Japan Joint Seminar on Crystallography p65-76 (1996).
- [12]W. -H. Li, S. Y. Wu, K. C. Lee, J. W. Lynn, R. S. Liu, J. B. Wu, and C. Y. Huang, J. Appl. Phys. 85, p5588-5590 (1999).
- [13]K. Ebata, M. Takizawa, K. Maekawa, A. Fujimori, H. Kuwahara, Y. Tomioka, and Y. Tokura, Phys. Rev. B 77, 094422 (2008).
- [14]Y. M. Xiong, G. Y. Wang, X. G. Luo and C. H. Wang, J. Appl. Phys. 97, 083909 (2005).
- [15]A. Barman and G. Koren, Appl. Phys. Lett. 77, 1674 (2000).
- [16]X. J.Chen, H.-U. Habermeier, H.Zhang, G. Gu, M.Varela, and C. C. Almasan, Phys. Rev. B 72, 104403 (2005).
- [17]M. Bibes, S. Valencia, Li. Balcells and B.Martinez, Phys. Rev. B 66, 134416 (2002).
- [18]K. Chahara, T. Ohno, M. Kasai, and Y. Kozono, Appl. Phys. Lett. 63, 1990 (1993).
- [19]R. von Helmolt, J. Weckerg, B. Holzapfel, L. Schultz, and K. Samwer, Phys. Rev. Lett. 71, 2331 (1993).
- [20]S. Jin, T. H. Tiefel, M. McCormack, R. A. Fastnacht, R. Ramesh, and L. H. Chen, Science 264, 413 (1994).
- [21]R. Shreekala, M. Rajeswari, S. P. Pai, S. E. Lofland, V. Smolyaninova, K. Ghosh, S. B. Ogale, S. M. Bhagat, M. J. Downes, R. L. Greene, R. Ramesh, and T. Venkatesan, Appl. Phys. Lett. 74, 2857 (1999).
- [22]Chen, A. Goyal, M. Rajeswari, C. Kwon, R. Ramesh, T, Venlatesan, R. Shreekala, S. E. Lofland, S. M. Bhagat, Appl. Phys. Lett. 71, 2535 (1997).
- [23]A. Barman and G. Koren, Appl. Phys. Lett. 77, 1674 (2000).
- [24]Alvydas Lissauskas, S. I. Khartsev, and Alex Grishin , Appl. Phys. Lett. 77, 756 (2000).
- [25]Fan. Yang, Laurence. Mechin, Jean-Marc. Routoure and Bruno. Guillee, J. Appl. Phys. 91, 7412 (2002).
- [26]Tong Li, Bo Wang, Hongyun Dai, Yongsheng Du, and Hui Yan, J. Appl. Phys. 98, 123505 (2002).
- [27]W. Prellier, M. Rajeswaari, T. Venkatesan, and R. L. Greene, Appl. Phys. Lett. 75, 1446 (1999).
- [28]A. Goyal, M. Rajeswari, R. Shreekala, S. E. Lofland, S. M. Bhagat, T. Boettcher,C. Kwon, R. Ramesh, and T. Venkatesan, Appl. Phys. Lett. 71, 27 (1997).
- [29]Soshin Chikazumi,Physics of Ferromagnetism (Whiley,New York, 1964) p.3.
- [30]B.D.Cullity,IntroductiontoMagneticMaterials(Addison-Wesley, Massachusetts,1972) p.85.
- [31]Robert C. O , Handley,Modern Magnetic Materials Principles and Applications (John Wiley and Sons,New York,2000).
- [32]M. Julliere, Phys. Lett. 54A, 225 (1975).
- [33]A. S. and A. M. Bratkovsky, Phys. Rev. Lett. 82, 141 (1999).
- [34]Guo-meng Zhao, V. Smolyaninova, W. Prellier, and H. Keller,Phys. Rev. Lett. 84 6086 (2000).
- [35]L. M. Wang, H. C. Yang, and H. E. Horng, " Electrical transport and carrier density collapse in doped manganite thin films " , Physical Review B 64, 224423 (2001).
- [36]G. J. Snyder, R. Hiskes, S. DiCarolis, M. R. Beasley, and T. H. Ge, Phys. Rev. B 53, 14 434 (1996).
- [37]T. Akimoto, Y. Moritomo, and A. Nakamura, Phys. Rev. Lett. 85, 3914 (2000).